



kingston.com/epop

ePoP

ePoP - ウェアラブル向け組込み POP (Package-on-Package) メモリ

Kingston の ePoP は、eMMC (Embedded MultiMedia Card) ストレージと LPDDR (Low-Power Double Data Rate) DRAM を POP (Package-on-Package) ソリューションに組み合わせた高集積 JEDEC 標準コンポーネントを提供します。ePoP は、対応するホスト SoC (System-on-a-Chip) の上に直接取り付けられますので、プリント回路基板 (PCB) のスペースを節約でき、パフォーマンスが最適化されます。ePoP は、ウェアラブルなどのスペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションです。

主な利点

- ePoP は、ホスト SoC の上に直接取り付けられますので、ウェアラブルなどのスペースに制約のあるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
- システム設計を簡素化し、開発と適格性判定の期間を短縮します。
- 省電力 DRAM と最適化されたストレージファームウェアによって、消費電力を削減する一方で、バッテリー式のウェアラブルアプリケーションに必要な高パフォーマンスを提供します。
- パフォーマンス、電力、寿命などアプリケーション要件に合わせて複数のファームウェア構成を利用できます。

市場セグメント



IoT



ウェアラブル



AR (拡張現実) /VR (仮想現実) デバイス

EPOP の製品番号と仕様

LPDDR3 ベースの ePoP

製品番号	容量		標準		パッケージ (mm)	FBGA	動作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EP04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	10x10x0.8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5.0	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x ベースの ePoP

製品番号	容量		標準		パッケージ (mm)	FBGA	動作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
08EP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C

*高耐久性には pSLC モード